



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102528277 B

(45) 授权公告日 2016.02.17

(21) 申请号 201210031247.0

(22) 申请日 2012.02.13

(73) 专利权人 中国科学院福建物质结构研究所
地址 350002 福建省福州市杨桥西路 155 号

(72) 发明人 黄见洪 翁文 刘华刚 葛燕
阮开明 邓晶 郑晖 李锦辉
史斐 戴殊韬 吴鸿春 林文雄

(74) 专利代理机构 北京庆峰财智知识产权代理
事务所(普通合伙) 11417
代理人 谢蓉

(51) Int. Cl.
B23K 26/064(2014.01)
B23K 26/38(2014.01)

审查员 顾新云

权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 发明名称

用于晶圆切割设备的紫外光学传输系统

(57) 摘要

本发明一种用于晶圆切割设备的紫外光学传输系统,涉及一种应用于LED晶圆切割紫外激光精密加工设备的光学传输设计方法,属于激光精密加工领域。本发明的目的在于提出一个新的紫外激光传输设计方案,减少紫外激光器衍射光束对LED芯片的辐射强度,提高LED芯片的寿命,并实现对激光器功率的方便调节和实时监控,对于整体提高晶圆切割设备的加工性能,具有重要的实际意义。

